

第 6 回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時:平成 26 年 7 月 11 日(金) 10:30~16:45

場所:自動車会館 大会議室(2F) (東京都千代田区)

時 間	題 目	講 演 者
	司会 三治 真佐樹((株)デンソー)	
10:30~ 12:00	『ソリューションに応じてはんだ材料を選択する時代へ』 (45分)	千住金属工業(株) ○ 吉川 俊策
	『Sn-3Ag-0.5Cu はんだと W 基板上 Ni めっきメタライズ界面に生成する Sn-W 構造』 (45 分)	(株)日立製作所 ○ 依田 智子、原田 正英 日本オクラロ(株) 西川 徹 群馬大学 小林 竜也、荘司 郁夫
12:00~ 13:00	昼 食 休 憩	
13:00~ 13:10	委 員 会 議 事	
	司会 渡邊 裕彦(富士電機(株))	
13:10~ 14:30	『ますます進歩する高熱伝導性樹脂の開発の現状と今後のトレンド』 (40分)	(地独)大阪市立工業研究所 ○上利 泰幸
	『半導体パワーモジュール絶縁基板の部分放電現象観察と耐電圧向上課題』 (40分)	富士電機(株) ○早瀬 悠二、山城 啓輔、 高野 哲美、外薮 洋昭
	休憩(15分)	
	司会 荘司 郁夫(群馬大学)	
14:45~ 16:45	『エンジン制御用コンピュータの熱シミュレーション技術』 (40 分)	(株)デンソー ○篠田 卓也
	『銅ペースト膜の抵抗率および残留応力に及ぼす焼成条件の影響』 (40 分)	ファインセラミックス技術研究組合 ○福田 真治、島田 和彦、山東 睦夫 産業技術総合研究所 伊豆 典哉、申ウソク、平尾 喜代司、 村山 宣光
	『粘塑性・クリープ分離型構成モデルの開発と鉛フリーはんだ接合部の疲労寿命評価』 (40 分)	東京工業高等専門学校 ○林 丈晴 富士電機(株) 渡邊 裕彦、浅井 竜彦 東京学芸大学 海老原 理徳

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。